合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2024-015

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演/反路演活动 □现场参加 □电话会议 □其他(请文字说明其他活动内容)
来访单位名称	长江证券、国联基金、汇丰晋信、南方基金、大成基金
时间	2024年5月13日
上市公司接待人员姓名	总经理: 杨宗铭 副总经理、董事会秘书、财务总监: 余成强 证券管理部经理: 李珮莹
投资者关系活动主要内容介绍	1.问:公司晶圆来源的情况? 答:公司晶圆来源超过半数系来自境内晶圆厂,如 SMIC、晶合集成、粤芯、华虹等,其他则由境外晶圆厂提供,如台积电、力积电、世界先进、UMC等。 2.问:关于重金属黄金等采购的价格浮动,对公司产品成本是否有所影响? 答:黄金主要用于显示驱动芯片上,而公司目前生产上所用到的黄金成本基本可转嫁至下游客户,由其承担价格波动的主要风险,因此近期的黄金价格波动对公司产品成本影响不大。 3.问:合肥厂未来的规划及产能? 答:结合合肥上游晶圆厂和下游面板厂的产业链完整度等情况,合肥厂预计以显示业务为主,负责12 吋晶圆的封装测试,首阶段产能规划为 BP 与 CP 各约1万片/月产能,COF约3,000万颗/月产能。 4.问:公司 AMOLED 的营收占比上升的原因? 答:受惠于 AMOLED 在手机应用的渗透率持续增加、显示面板产业向中国大陆转移以及国内显示芯片供应链已趋于完善等因素,AMOLED 营收占比逐步增加。
关于本次活动是否涉及应 当披露重大信息的说明	本次活动,公司严格按照相关规定交流沟通,不存在未公开重 大信息泄露等情形。

附件清单(如有)	无
日期	2024年5月14日